

NC273LT 免洗焊锡膏

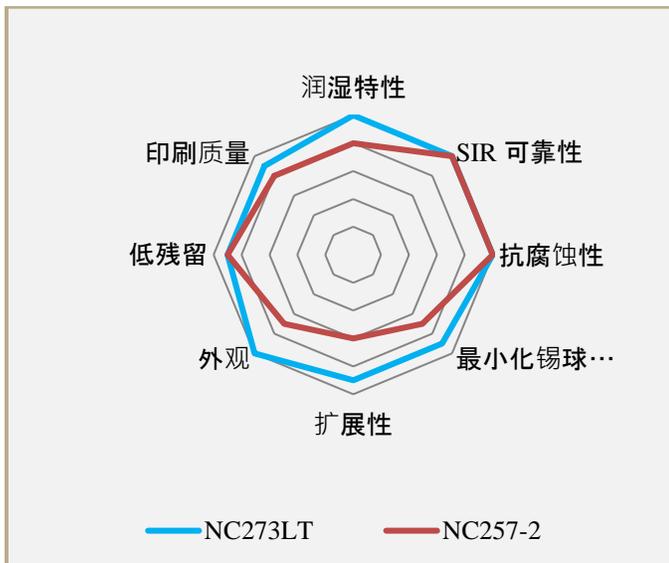
特性

- ▶ 设计用于低温
- ▶ 符合RoHS
- ▶ 提高合金湿润性
- ▶ 最小化锡球缺陷
- ▶ 长钢板停留时间
- ▶ 无卤素

描述

随着AIM 革命性活化剂产品的加入, NC273LT低温锡膏大大提高了RoHS认证的电镀和表面处理的所需钎合金的润湿性, 同时确保钢板停留寿命长, 优良的传输效率和最大限度地减少高钎材料共有的锡球问题。钎焊膏可以减少峰值回流温度要求, 可低至170°C - 185°C (338°F - 365°F)。与任何含钎合金一样, 组装必须是完全无铅的。

特性



*无铅合金.



操作和储存

参数	时间	温度
冷冻密封保质期	6个月	< 0°C (32°F)
冷藏密封保质期	4个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
非冷藏密封保质期	2周	< 25°C (< 77°F)

请勿将使用过的焊膏添加到未使用过的锡膏中。使用过的锡膏要与未使用过的锡膏分开储存; 对未使用的锡膏, 要将内盖或顶盖盖好并重新密封。开封后锡膏的保质期取决于环境和应用, 详情请见AIM焊膏使用指导。合金的成分和贮存条件可能会影响保质期。请参阅NC273LT分析证书中的特定信息。

清洗

回流前: 在进程中, AIM DJAW-10 可将NC273LT有效的从钢网上清除。可手工将DJAW-10 应用在钢网擦拭设备上。DJAW-10 不会让 NC273LT变干并且会加强传输性能。请勿过量使用DJAW-10。不要把DJAW-10涂于钢网顶部。不推荐在工艺过程中使用异丙醇 (IPA), 但可用于最后钢网清洗。

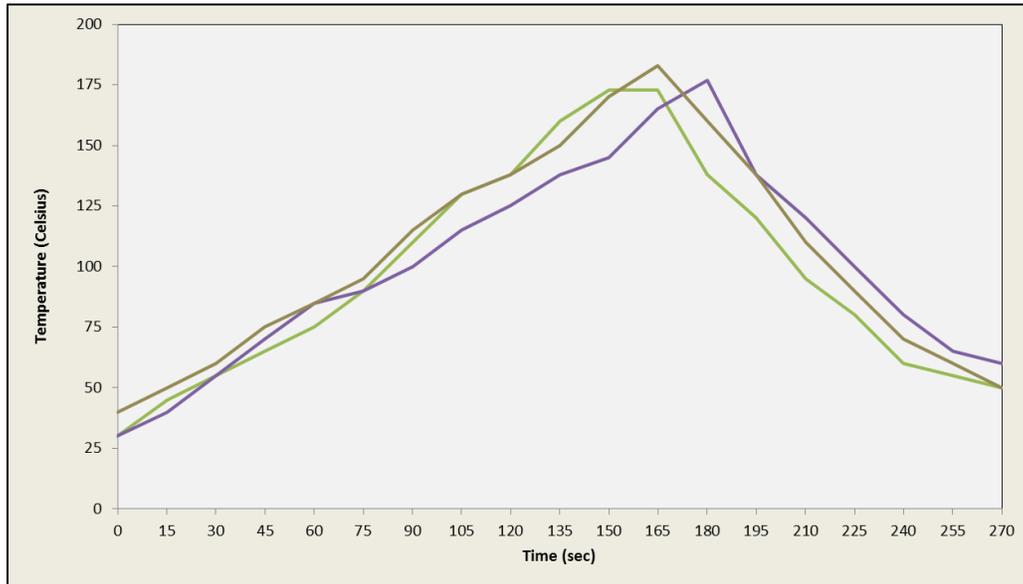
回流后残留: NC273LT 可能会在回流后有残留存在存在在组件上, 无需清洗。若有要求清洗, AIM已与行业伙伴合作确保NC273LT残留可用普通助焊残留清洗剂清洗。请联系AIM获得清洁兼容性信息。

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息, 请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供, 产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产, 造成的损失或伤害, 不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。

回流曲线

阴影部分定义为工艺窗口，可能与您的回流图有所不同。元器件的限制、炉子的效率、板子尺寸/质量、元器件类型和密度都影响某一指定组件的最终回流曲线。推荐的回流曲线只作为一种指导，如果你需要其他的协助请联系AIM的技术支持工程师。<http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>.



升温斜率 最大 每秒 1-3° C / SEC	升温到 100° C (212° F)	100° C到140° C (212° F-284° F) 之 间的时间	170° C-185° C (338° F-365° F) 到达峰值时间	138° C (280° F) 温度以上	冷却速度 ≤ 4° C / SEC	冷却时间
	≤ 75 秒	30-60 秒	45-75 秒	50-80 秒	45± 15 秒	2.75-3.5 分钟

印刷

以下推荐的印刷机初始设定取决于PCB和PAD设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.9 - 1.5 磅/英寸每刀片
刮刀速度	0.5 - 6 英寸/秒
接触距离	接触0.00毫米 (0.00英寸)
PCB 分离距离	0.75-2.0 毫米 (.030-.080英寸)
PCB 分离速度	3.0 - 20.00 毫米/秒

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

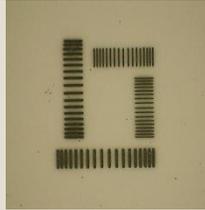
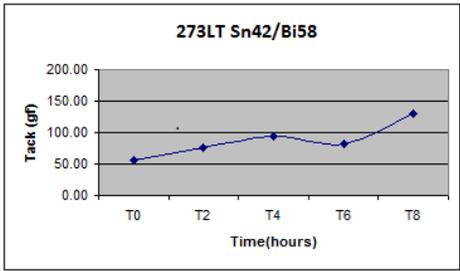
免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入<http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。

测试数据总结

项目	测试方法	结果	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004 3.2.3.1	ROLO	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ROL1	
项目	测试方法	典型值	图片
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>后</p>  </div> </div>
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	溴: 0.23% 氯: 0.0% 典型值	
卤素含量	EN14582	<900ppm Br/Cl <1500ppm	无卤素
定量卤化物、铬 酸银测试	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟 化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	不含氟	
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过	
助焊剂固体含 量、非挥发性测 定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.17 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	159.4 mg KOH/ g flux	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.98	
粘度	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	印刷配方: 750kcps典型值 点涂配方: 400kcps 典型值	

* 所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。

项目	测试方法	正常值	图片												
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	灰色，平滑，粘稠													
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过													
锡球测试	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过													
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	55. 3gf	 <table border="1"> <caption>273LT Sn42/Bi58 Tack Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (hours)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>T8</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table>	Time (hours)	Tack (gf)	T0	50	T2	75	T4	95	T6	80	T8	130
Time (hours)	Tack (gf)														
T0	50														
T2	75														
T4	95														
T6	80														
T8	130														
润湿度	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过													

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。